

LPKF MicroLine 1000 S



Nowy laserowy system do depanelowania jest bardzo atrakcyjną i ekonomiczną alternatywą dla wysokonakładowych producentów obwodów drukowanych.

Pod koniec czerwca 2010 firma LPKF wprowadziła na rynek nowy laserowy system- MicroLine 1000 S. Jest on przykładem bardzo kompaktowego i ekonomicznego lasera UV, stosowanego do cięcia zmontowanych obwodów drukowanych. Według Dr Ingo Bretthauer, dyrektora LPKF'u, ten system nadażę za rozwojem technologii: "MicroLine 1000 S łączy w sobie niską cenę z wysoką jakością cięcia oraz uniwersalność procesu. Jest także elastyczny, umożliwiając tym samym dostosowanie go do różnych wersji produktów. Źródła promieniowania laserowego, które używamy, zostało zoptymalizowane pod kątem tych aplikacji".



Zastosowanie promienia lasera UV jako narzędzia do cięcia zmontowanych oraz niezmontowanych obwodów drukowanych pozwoli na zaoszczędzenie wolnego miejsca na płytce. Możliwe jest również cięcie w małej odległość od delikatnych podzespołów bez mechanicznych czy termicznych naprężeń. Skomplikowany kształt obrysu pytki nie stanowi problemu. Zmiany ścieżki cięcia dokonuje się poprzez oprogramowanie dostarczane wraz z systemem lub w programie CAD.

Nowy system został zaprezentowany na targach SMT w Norymberdze.

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



spezial electronic

SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl